



ニュースリリース

平成19年8月10日

独立型2ステージの 超高速パッケージシンギュレーション装置「PS280」を販売開始

株式会社東京精密(代表取締役社長 CEO 兼 COO:鈴木貞勝)は、CSP (Chip Scale Package) 基板*¹ (BGA*²、QFN 基板*³等)をダイヤモンドブレードでチップ分割する独立型2ステージダイシング装置「PS280」を開発し販売開始する。

「PS280」は他社製ピック&プレースユニット(以下ハンドラー)と接続して使用し、ハンドラーから供給された基板を自動切断し排出する装置である。従来機ではハンドラーとの処理能力の差により、スピードの遅いダイシング側で全体のパフォーマンスが決まっていたが、「PS280」は、2ステージがそれぞれ独立して動くことにより、高速化を実現した(特許取得済み)。

「PS280」の特徴

「PS280」は、当社製品比で処理能力を倍増した仕様により、ハンドラーと接続した高速切断が可能となり、全体のパフォーマンスは大幅に向上。

基板の切断部から独立した自動アライメント機能を搭載しており、一つのステージで切断作業中にもう一つのステージで位置決めを行うことにより、全体的な処理時間の高速化を実現。

各軸1本計2本のスピンドルには高出力DC ブラシレスモータが採用されており、負荷のかかるCSP 基板を高速切断が可能。

パッケージシンギュレーション装置は、主にCSP等の基板をダイシングテープを使用せずに、高精度かつ低コストで個片化するためのシステムであり、市場は急速に拡大しており、2008年には市場規模300億円に達する見込みである。

販売予定時期: 2007年9月

*1 「CSP 基板」: ベアチップとほぼ同じか、わずかに大きい寸法のパッケージ

*2 「BGA 基板」: パッケージ底面にボールバンプをマトリクス配置した表面実装パッケージ

* *3 「QFN 基板」: 4方向すべての外部端子がパッケージの裏面に配置されている表面実装型パッケージ

